



鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

HTG-700 常规系列

【单组份导热凝胶】规格书



-产品图-

鸿富诚 HTG-700系列 单组份导热凝胶是一种高适配性的热界面材料，该材料具有比超软导热硅胶垫片更优越的应力应变值，可自动点胶涂覆，是多个芯片共用一个散热器/结构件场合最佳的方案选择。

应用特点：

- 7.0(±0.5)W/m.K 导热系数
- 以不定形状替代传统的组装式片材
- 可通过各种手工或自动化的工艺进行点胶
- 柔软，可消除装配应力，减震阻尼

应用领域推荐：

- 半导体块和散热器
- 用于LED灯具和发光体、汽车和消费领域
- 点胶或直接涂覆成各种厚度和形状
- 高性能中央处理器及显示卡处理器

应用方式：

单组份导热凝胶可通过各种方式使用，包括：自动点胶、手动涂覆。

包装：

根据不同需求，可以按照30CC和300cc单组份EFD针管或者其他容量的桶包装。

该系列产品环保符合RoHS2.0、卤素、REACH标准。

储存条件：

- 阴暗处储存，
- 储存温度：≤30℃；
- 储存湿度：≤70%；

保质期：

- 在储存条件下：1年
- 不符合储存条件下：6个月

产品性能

NO.	参数	单位	测试方法
颜色	灰色	--	目视
密度	3.15(±0.3)	g/cc	ASTM D 792
挤出速率 @90 psi	≥30	g/min	φ2.41mmEFD注射头
最小填充缝隙	≤0.2	mm	--
防火性能	V0	--	UL 94
使用温度	-40~150	°C	IEC 60068-2-14

特学特性

导热系数	7.0(±0.5)	W/m·K	ASTM D 5470
热阻	≤0.06 (@20psi)	°Cin ² /W	ASTM D 5470

电学特性

击穿电压	≥5	kV /mm	ASTM D 149
体积电阻率	≥10 ⁸	Ω.cm	ASTM D 257
介电常数	≥2	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	≤0.1	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权